

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）		
参与单位名称及参会人员姓名	易方达基金 景顺长城 华安基金 工银瑞信 华宝基金 信达澳亚 德邦基金 聚鸣投资 冲积资产 泽源资产 澹易资产 江天投资 国华兴益 合众易晟	李凌霄 刘煜 吴运阳 马丽娜 刘文正 齐兴方 徐进 陈奇 褚壹钦 吴亚平 包夏茜 王冠杰 孙玥 唐紫阳	景顺长城 招商基金 工银瑞信 国投瑞银 申万菱信 信达澳亚 泉果基金 聚鸣投资 域秀资本 泽源资产 敦颐资产 前海人寿 上犹益憬 长江证券	贡学博 张统 单文 汤龑 徐巡 冯明远 杜凡 史书 郭旺 曾洁 薛浩洲 李克强 张轶乾 孟星
会议时间	2026年1月27日			
会议地点	现场会议			
上市公司接待人员姓名	董事长 董事会秘书 投资者关系与市值管理负责人	杨新元 杨春雷 索子欣		
会议问题	1、请问公司晶体生长设备是否已经实现国产化？ 答：12英寸硅片生产对原材料、设备及工艺的融合度要求极高，公司高度重视12英寸硅片生产过程中所使用原材料与设备的自主可控。公司借鉴行业头部企业经验，针			

对晶体生长设备这一核心工艺设备，在成立初期便与高校开展联合研发，目前公司晶体生长设备在性能等核心指标上比肩海外同类可采购设备，已实现自主可控且不断迭代升级。

2、请问公司与海外头部企业是否存在差距？

答：公司作为 12 英寸国内头部企业，已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能等核心指标已与全球前五大厂商处于同一水平，但整体较海外头部仍存在一定差距，这是国内硅片行业作为“后来者”发展过程中的阶段现象。

具体而言，主要应用于 DRAM、NAND 等存储芯片领域的抛光片产品，基本与海外头部处于同一水平，其中应用于 3D NAND 等产品的抛光片产品，在应用层面与海外持平；主要应用于 CPU、GPU 等逻辑芯片领域的外延片产品，较海外头部仍存在一定差距。

3、请问公司整体产能、产品出货情况如何，生产线整体稼动率处于怎样的水平？

答：公司自设立之初就制定了 15 年的远期战略规划，计划通过 2-3 个基地投资建设若干座现代化 12 英寸硅片工厂，最终成为 12 英寸硅片领域全球领先企业。目前公司已布局西安和武汉两个基地，投资建设了三座工厂。其中第一工厂已满产，第二工厂产能爬坡中，第三工厂全面启动建设，2026 年年底第二工厂达产后公司将具备约 120 万片/月产能，2027 年第三工厂将实现首期投产，三座工厂满产后公司将实现约 180 万片/月产能。

截至 2025 年 12 月公司已具备约 85 万片/月产能，受益于半导体行业筑底回升态势，公司产线整体稼动率 90%以上。

4、请问目前公司收入结构中，抛光片、外延片的占比分别约为多少，未来趋势？

答：公司产品布局紧密贴合市场需求，2025 年抛光片（含高端测试片）收入占比约 55%，外延片约 20%。随着第一工厂运营效能持续提升、第二工厂逐步达产，公司出货量将有望保持稳步增长，产品结构也将进一步优化；同时基于当前公司海外客户开拓情况，海外销售规模将持续扩大。

5、请介绍公司的市场地位？

答：公司持续位居 12 英寸硅片领域国内头部，实现了国内一线晶圆代工厂和存储 IDM 厂大多数主流量产工艺平台的正片供货，已成为国内主流存储 IDM 厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商，已成为国内一线逻辑晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二的供应商，已成为目前国内新建 12 英寸晶圆厂的首选硅片供应商之一。

在海外客户开拓方面，公司自成立之初便确立了立足国内、放眼全球的市场策略，坚持与全球头部标杆客户深度合作，在合作中精准发现自身短板与差距，以此实现技术能力的快速提升与突破。公司持续向海外头部晶圆制造厂商量产供货，供应比例占客户

采购比例尚不高，海外销售收入占公司营收近 30%，未来我们将持续深化合作，提升供应规模。

6、请问下游需求旺盛，是否会对公司产品价格形成积极带动？

答：人工智能、数据中心等应用对算力及存储领域需求的增长成为驱动行业增长的核心引擎。行业整体处于筑底调整与动能积蓄阶段，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体市场规模预计同比增长 22.5%。受益于半导体行业的逐步复苏，半导体硅片市场呈现向好态势，根据国际半导体产业协会（SEMI）数据显示，2025 年全球半导体硅片出货面积预计同比增长 5.4%。此外在芯片 3D 堆叠技术的驱动下，未来硅片需求增长率有望进一步提升。

从市场环境来看，尽管半导体行业复苏态势明确，但当前下游客户需求向半导体硅片环节的传导存在滞后性。目前公司产品价格与去年基本持平，处于较低水平，随着公司第二工厂满产，产品及客户结构持续优化，产品平均单价有望实现优化。